




平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況

平成 20年 2月 5日

上場会社名  東京エレクトロン株式会社
 コード番号 8035
 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 潔
 問合せ先責任者 経理部長 佐伯 幸雄

上場取引所 東証一部
 U R L <http://www.tel.com/>
 T E L (03)5561-7000

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第3四半期の連結業績 (平成19年4月1日～平成19年12月31日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第3四半期	676,215	12.6	133,504	32.0	135,557	35.1	88,064	37.1
19年3月期第3四半期	600,656	25.6	101,145	90.1	100,320	86.7	64,212	88.2
19年3月期	851,975		143,978		143,940		91,262	

	1株当たり四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20年3月期第3四半期	492	27	491	07
19年3月期第3四半期	359	91	358	87
19年3月期	511	27	509	84

(2) 連結財政状態

	総 資 産	純 資 産	自 己 資 本 比 率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
20年3月期第3四半期	785,155	531,331	66.4	2,914	44
19年3月期第3四半期	704,273	438,730	61.5	2,422	68
19年3月期	770,513	469,810	59.7	2,573	72

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
20年3月期第3四半期	41,250	47,494	26,826	101,176
19年3月期第3四半期	17,836	24,768	32,752	100,576
19年3月期	54,296	25,293	34,719	134,389

2．平成20年3月期の連結業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

連結業績予想につきましては、平成19年5月11日に発表した通期の業績予想と変更ありません。

3．その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

(注) 連結業績予想につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

経営成績及び財政状態

1. 業績の概況

(1)9ヶ月間通算(平成19年4月1日～平成19年12月31日)

当4-12月期の連結業績は、売上高6,762億1千5百万円(前年同期比12.6%増)、営業利益1,335億4百万円(前年同期比32.0%増)、経常利益1,355億5千7百万円(前年同期比35.1%増)、当期純利益880億6千4百万円(前年同期比37.1%増)となりました。

連結売上高を部門別に見ますと、半導体製造装置部門は売上高5,399億9千万円(前年同期比22.0%増)、FPD製造装置部門は536億4千8百万円(前年同期比31.7%減)、電子部品・情報通信機器部門は822億5千1百万円(前年同期比4.8%増)となりました。主力の半導体製造装置部門はアジアのメモリーメーカー向けの売上が好調に推移し、FPD製造装置部門は前期の高水準な状況から一時的な調整となりました。

なお、従来、「コンピュータ・システム及びネットワーク」は、「産業用電子機器」セグメントに区分しておりましたが、前下半期より「電子部品・情報通信機器」(旧「電子部品」)セグメントの中に含めております。これに伴い、各部門における売上高の前年同期との比較は、変更後の区分により組替表示しております。

(2)当第3四半期(平成19年10月1日～平成19年12月31日の3ヶ月間)

当第3四半期の連結業績につきましては、売上高1,998億3千7百万円(前年同期比4.9%減)、営業利益384億9千9百万円(前年同期比10.3%減)、経常利益397億6千1百万円(前年同期比5.6%減)、当期純利益256億円(前年同期比5.1%減)となりました。連結売上高を部門別に見ますと、半導体製造装置部門は売上高1,607億3千9百万円(前年同期比1.2%増)、FPD製造装置部門は100億4千8百万円(前年同期比61.4%減)、電子部品・情報通信機器部門は289億8千万円(前年同期比15.9%増)となりました。

(ご参考)【連結】

(単位:百万円)

	中間期	第3四半期	9ヶ月間通算
売上高	476,377	199,837	676,215
産業用電子機器事業	423,106	170,857	593,963
半導体製造装置	379,251	160,739	539,990
日本	94,629	52,248	146,878
米国	52,479	22,302	74,782
欧州	14,447	4,157	18,604
韓国	41,122	15,581	56,703
台湾	141,934	53,639	195,573
中国	20,525	4,188	24,714
東南アジア他	14,112	8,620	22,732
FPD製造装置	43,600	10,048	53,648
その他	254	69	324
電子部品・情報通信機器事業	53,271	28,980	82,251
営業利益	95,005	38,499	133,504
経常利益	95,795	39,761	135,557
当期純利益	62,463	25,600	88,064

(注)セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 当第3四半期末の財政状態

当第3四半期末の総資産は、売掛金の増加等により、前期末から146億4千1百万円増加の7,851億5千5百万円となりました。負債合計は、買掛金の減少、法人税等の支払等により前期末から468億7千9百万円減少の2,538億2千3百万円となりました。純資産は、当期純利益880億6千4百万円を計上したことによる増加、剰余金の配当234億3千1百万円による減少等の結果、前期末から615億2千万円増加の5,313億3千1百万円となり、自己資本比率は66.4%となりました。

3. 9ヶ月間通算(平成19年4月1日～平成19年12月31日)のキャッシュ・フローの状況

9ヶ月間通算の各キャッシュ・フローの状況と要因は、次のとおりであります。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローにつきましては、412億5千万円となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益1,382億1千7百万円、減価償却費153億7千5百万円がそれぞれキャッシュ・フローのプラスとなった一方、売上債権の増加108億3千1百万円、仕入債務の減少260億2千3百万円、法人税等の支払額724億5千9百万円がキャッシュ・フローのマイナスとなりました。

投資活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主として生産・研究開発用有形固定資産の取得147億1千万円、定期預金の預入等340億円等により、474億9千4百万円となりました。

財務活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主に第5回無担保新株引受権付社債55億円の償還、配当金の支払234億3千1百万円により268億2千6百万円となりました。

この結果、現金及び現金同等物の第3四半期末残高は、前期末に比べ332億1千2百万円減少し、1,011億7千6百万円となりました。

(要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	前 期 末 (平成19年3月期末)	当 四 半 期 末 (平成20年3月期 第3四半期末)	増 減		前 年 同 四 半 期 末 (平成19年3月期 第3四半期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資 産 の 部)				%	
流 動 資 産	610,363	624,444	14,081	2.3	547,415
現金及び預金	134,389	67,204			100,576
受取手形及び売掛金	228,688	239,676			203,193
有 価 証 券	19	67,972			19
た な 卸 資 産	194,840	198,689			200,060
そ の 他	52,551	50,991			43,771
貸 倒 引 当 金	△ 127	△ 90			△ 206
固 定 資 産	160,150	160,710	559	0.3	156,858
有 形 固 定 資 産	104,930	105,778			102,067
無 形 固 定 資 産	19,399	18,494			19,771
投 資 そ の 他 の 資 産	36,118	36,733			35,333
貸 倒 引 当 金	△ 297	△ 297			△ 313
資 産 合 計	770,513	785,155	14,641	1.9	704,273

(単位：百万円)

期 別 科 目	前 期 末 (平成19年3月期末)	当 四 半 期 末 (平成20年3月期 第3四半期末)	増 減		前 年 同 四 半 期 末 (平成19年3月期 第3四半期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)				%	
流動負債	225,854	205,959	△ 19,895	△ 8.8	187,943
支払手形及び買掛金	83,837	57,922			72,727
一年以内償還予定社債	5,500	30,000			5,500
未払法人税等	45,657	23,384			22,511
前受金	21,956	39,810			33,264
賞与引当金	14,131	6,009			6,188
製品保証引当金	14,114	9,630			13,255
その他の	40,658	39,202			34,496
固定負債	74,848	47,863	△ 26,984	△ 36.1	77,600
社債	30,000	-			30,000
退職給付引当金	40,018	42,945			38,870
役員退職慰労引当金	666	657			661
その他の	4,162	4,260			8,067
負債合計	300,702	253,823	△ 46,879	△ 15.6	265,543
(純資産の部)					
株主資本	449,166	514,630	65,463	14.6	421,596
資本金	54,961	54,961			54,961
資本剰余金	78,346	78,393			78,309
利益剰余金	328,026	392,659			300,976
自己株式	△ 12,167	△ 11,383			△ 12,650
評価・換算差額等	11,008	6,848	△ 4,159	△ 37.8	11,366
新株予約権	584	374	△ 209	△ 35.9	548
少数株主持分	9,051	9,478	426	4.7	5,219
純資産合計	469,810	531,331	61,520	13.1	438,730
負債純資産合計	770,513	785,155	14,641	1.9	704,273

(要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前 年 同 四 半 期 (平成19年3月期) (第3四半期)		当 四 半 期 (平成20年3月期) (第3四半期)		増 減		(参考) 前 期 (平成19年3月期)	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	増減率	金 額	百 分 比
		%		%		%		%
売 上 高	600,656	100.0	676,215	100.0	75,558	12.6	851,975	100.0
売 上 原 価	407,321	67.8	438,429	64.8	31,107	7.6	579,325	68.0
売 上 総 利 益	193,334	32.2	237,786	35.2	44,451	23.0	272,649	32.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	92,189	15.4	104,281	15.5	12,091	13.1	128,670	15.1
営 業 利 益	101,145	16.8	133,504	19.7	32,359	32.0	143,978	16.9
営 業 外 収 益	3,371		3,669				4,908	
営 業 外 費 用	4,195		1,616				4,946	
経 常 利 益	100,320	16.7	135,557	20.0	35,236	35.1	143,940	16.9
特 別 利 益	753		3,057				2,721	
特 別 損 失	458		397				2,247	
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	100,615	16.8	138,217	20.4	37,602	37.4	144,414	17.0
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	36,034	6.0	49,406	7.3			60,132	7.1
法 人 税 等 調 整 額	-	-	-	-			△ 7,534	△ 0.9
少 数 株 主 利 益	368	0.1	747	0.1			553	0.1
四 半 期 (当 期) 純 利 益	64,212	10.7	88,064	13.0	23,851	37.1	91,262	10.7

セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

(単位：百万円)

前年同四半期	〔 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日 〕				
	産業用 電子機器	電子部品・ 情報通信機器	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	522,154	78,501	600,656	-	600,656
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	2,029	867	2,896	(2,896)	-
計	524,183	79,369	603,553	(2,896)	600,656
営業費用	425,563	76,515	502,078	(2,566)	499,511
営業利益	98,620	2,854	101,475	(329)	101,145

(単位：百万円)

当第3四半期	〔 自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日 〕				
	産業用 電子機器	電子部品・ 情報通信機器	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	593,963	82,251	676,215	-	676,215
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	824	756	1,580	(1,580)	-
計	594,788	83,008	677,796	(1,580)	676,215
営業費用	464,066	80,248	544,315	(1,604)	542,710
営業利益	130,721	2,759	133,480	24	133,504

(単位：百万円)

(参考) 前期	〔 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日 〕				
	産業用 電子機器	電子部品・ 情報通信機器	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	744,512	107,462	851,975	-	851,975
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	2,381	1,247	3,628	(3,628)	-
計	746,893	108,709	855,603	(3,628)	851,975
営業費用	606,539	104,739	711,279	(3,282)	707,996
営業利益	140,354	3,969	144,324	(345)	143,978

2. 所在地別セグメント情報

(単位：百万円)

前年同四半期	〔 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日 〕				
	日 本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	523,610	77,045	600,656	-	600,656
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	52,681	33,854	86,536	(86,536)	-
計	576,292	110,900	687,193	(86,536)	600,656
営業費用	481,103	102,972	584,075	(84,564)	499,511
営業利益	95,189	7,928	103,117	(1,972)	101,145

(単位：百万円)

当第3四半期	〔 自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日 〕				
	日 本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	608,656	67,558	676,215	-	676,215
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	57,149	40,007	97,157	(97,157)	-
計	665,806	107,566	773,372	(97,157)	676,215
営業費用	533,133	99,751	632,884	(90,174)	542,710
営業利益	132,673	7,814	140,487	(6,983)	133,504

(単位：百万円)

(参考) 前期	〔 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日 〕				
	日 本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	749,281	102,693	851,975	-	851,975
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	69,936	48,525	118,461	(118,461)	-
計	819,218	151,219	970,437	(118,461)	851,975
営業費用	683,388	140,782	824,171	(116,174)	707,996
営業利益	135,829	10,436	146,266	(2,287)	143,978

3. 海外売上高

(単位：百万円)

前年同四半期		〔自平成18年4月1日 至平成18年12月31日〕			
	台湾	韓国	米国	その他	計
海外売上高	130,680	77,258	74,767	91,016	373,723
連結売上高					600,656
連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	21.8	12.9	12.4	15.1	62.2

(単位：百万円)

当第3四半期		〔自平成19年4月1日 至平成19年12月31日〕			
	台湾	米国	韓国	その他	計
海外売上高	204,362	74,827	69,643	75,951	424,784
連結売上高					676,215
連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	30.2	11.1	10.3	11.2	62.8

(単位：百万円)

(参考) 前期		〔自平成18年4月1日 至平成19年3月31日〕			
	台湾	韓国	米国	その他	計
海外売上高	182,918	122,627	105,716	126,895	538,159
連結売上高					851,975
連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	21.5	14.4	12.4	14.9	63.2

生産、受注及び販売の状況

1. 生産実績

(単位：百万円)

事業部門	前年同四半期 〔自平成18年4月1日〕 〔至平成18年12月31日〕	当第3四半期 〔自平成19年4月1日〕 〔至平成19年12月31日〕	(参考) 前期 〔自平成18年4月1日〕 〔至平成19年3月31日〕
	生産高	生産高	生産高
産業用電子機器	514,949	595,240	713,896
半導体製造装置	440,718	547,425	619,332
F P D 製造装置	74,230	47,814	94,564
合計	514,949	595,240	713,896

2. 受注実績

(単位：百万円)

事業部門	前年同四半期 〔自平成18年4月1日〕 〔至平成18年12月31日〕	当第3四半期 〔自平成19年4月1日〕 〔至平成19年12月31日〕	(参考) 前期 〔自平成18年4月1日〕 〔至平成19年3月31日〕
	受注高	受注高	受注高
産業用電子機器	641,196	474,966	868,464
半導体製造装置	577,676	405,813	800,434
F P D 製造装置	62,691	68,828	66,908
その他	827	324	1,120
電子部品・情報通信機器	82,017	84,390	108,782
合計	723,213	559,356	977,246

事業部門	前年同四半期 (平成18年12月31日現在)	当第3四半期 (平成19年12月31日現在)	(参考) 前期 (平成19年3月31日現在)
	受注残高	受注残高	受注残高
産業用電子機器	467,270	353,183	472,180
半導体製造装置	384,101	272,791	406,969
F P D 製造装置	83,168	80,391	65,211
電子部品・情報通信機器	16,288	16,231	14,092
合計	483,558	369,414	486,273

3. 販売実績

(単位：百万円)

事業部門	前年同四半期 〔自平成18年4月1日〕 〔至平成18年12月31日〕	当第3四半期 〔自平成19年4月1日〕 〔至平成19年12月31日〕	(参考) 前期 〔自平成18年4月1日〕 〔至平成19年3月31日〕
	販売高	販売高	販売高
産業用電子機器	522,154	593,963	744,512
半導体製造装置	442,734	539,990	642,625
F P D 製造装置	78,592	53,648	100,766
その他	827	324	1,120
電子部品・情報通信機器	78,501	82,251	107,462
合計	600,656	676,215	851,975